

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（投资者开放日）
参与单位名称及人员姓名	招商基金、兴业证券
时间	2026年3月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 产品价格变动趋势？</p> <p>整体而言，公司产品价格呈现稳中向好的情况。一方面，以金属类大宗商品为代表的上游原材料价格持续上涨，公司会根据成本变动情况动态调整产品价格；同时，公司产能稼动率维持在较高水平，部分客户也会出于保证产能、缩短交期等目的主动溢价。</p> <p>2. 2026年稼动率水平？</p> <p>通常而言封测行业一季度由于春节假期影响，稼动率较四季度会有所回落，但第一季度公司整体稼动率仍维持在较高水平，预计全年稼动率将保持在高位。</p> <p>3. 2026年订单预期？</p> <p>一方面，中国台湾地区头部封测企业因AI相关需求持续旺盛产能紧张，将消费类封装产能转向至AI/HPC等产品，导致消费类电子订单外溢；另一方面，随着大客户新品的承接以及海外大客户的进一步拓展，总体上公司对于2026年的订单预期较为乐观。</p> <p>4. 2026年Q1及Q2客户需求预期？</p> <p>2026年Q1的客户需求整体呈现淡季不淡的特点；2026年Q2的客户给出的需求Forecast也是相对较为旺盛</p>

	<p>的。</p> <p>5. 2.5D 先进封装产线进展情况？</p> <p>公司 2.5D 封装产线于 2024 年四季度通线，目前正在和相关客户做产品验证，整体进展顺利。但由于 2.5D 封装产品工艺复杂，验证周期较长，实现稳定量产需要一定时间。公司目前与客户送样产品取得了客户积极认可。产能方面，公司后续会根据客户需求及国产先进制程产能释放节奏进行扩产。</p> <p>6. 硅桥封装方案相对于硅转接板封装方案的优势？</p> <p>从性能角度，部署更加灵活，实现更大面积的 Reticle Size，可以进行多颗 SOC 芯片合封，性能会有提升；从成本角度，无需使用整片硅转接板，替换为硅桥，BOM 成本会下降，但封装端更为复杂。</p> <p>7. 公司未来业务增长点？</p> <p>公司未来主要业务增长主要来自现有核心客户的成长、海外大客户的持续拓展及先进封装产品线未来量产的贡献。首先，公司身为国内头部端侧 SoC 客户的核心供应商，承接了较多的新品开发项目，会伴随其业务量一同成长；其次，基于 local-for-local 的供应链模式趋势以及公司自身在成本、交付、服务、稳定性等方面的竞争力，海外新客户拓展顺利，未来营收占比将逐年增加；最后，未来随着公司 2.5D 封装产线实现量产及国产先进制程产能释放，该部分业务将会贡献可观营收。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 3 月 17 日

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。